

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成24年1月12日(2012.1.12)

【公開番号】特開2010-212584(P2010-212584A)  
 【公開日】平成22年9月24日(2010.9.24)  
 【年通号数】公開・登録公報2010-038  
 【出願番号】特願2009-59327(P2009-59327)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 W

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

本発明によれば、以下に示す回路基板用金属箔テープが提供される。

- 〔1〕 予め回路が形成された回路基板にラミネートされて使用される金属箔テープであって、少なくとも金属箔と接着剤層からなり、該金属箔の厚みが5～100 $\mu$ mであり、該接着剤層の厚みが2～40 $\mu$ mであることを特徴とする回路基板用金属箔テープ。
- 〔2〕 前記金属箔の引張破壊伸びが3%以上であることを特徴とする前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。
- 〔3〕 前記金属箔の引張弾性率が5～40GPaであることを特徴とする前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。
- 〔4〕 前記金属箔がアルミニウム箔であることを特徴とする前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。
- 〔5〕 前記接着剤がアクリル系接着剤であることを特徴とする前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。
- 〔6〕 前記接着剤層がアクリル系接着剤からなり、該アクリル系熱接着剤がアクリル系ポリマーとエポキシ硬化剤を含有することを特徴とする前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。
- 〔7〕 前記接着剤層を構成する接着剤の硬化後の引張弾性率が10MPa以下であることを特徴とする前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。
- 〔8〕 前記接着剤層に離型性フィルムが積層されていることを特徴とする請求項前記〔1〕に記載の回路基板用金属箔テープ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

予め回路が形成された回路基板にラミネートされて使用される金属箔テープであって、少なくとも金属箔と接着剤層からなり、該金属箔の厚みが5～100 $\mu$ mであり、該接着

剤層の厚みが  $2 \sim 40 \mu\text{m}$ であることを特徴とする回路基板用金属箔テープ。

【請求項 2】

前記金属箔の引張破壊伸びが 3%以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。

【請求項 3】

前記金属箔の引張弾性率が  $5 \sim 40 \text{GPa}$ であることを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。

【請求項 4】

前記金属箔がアルミニウム箔であることを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。

【請求項 5】

前記接着剤層がアクリル系接着剤からなることを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。

【請求項 6】

前記接着剤層がアクリル系接着剤からなり、該アクリル系接着剤層がアクリル系ポリマーとエポキシ硬化剤を含有することを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。

【請求項 7】

前記接着剤層を構成する接着剤の硬化後の引張弾性率が  $10 \text{MPa}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。

【請求項 8】

前記接着剤層に離型性フィルムが積層されていることを特徴とする請求項 1 に記載の回路基板用金属箔テープ。